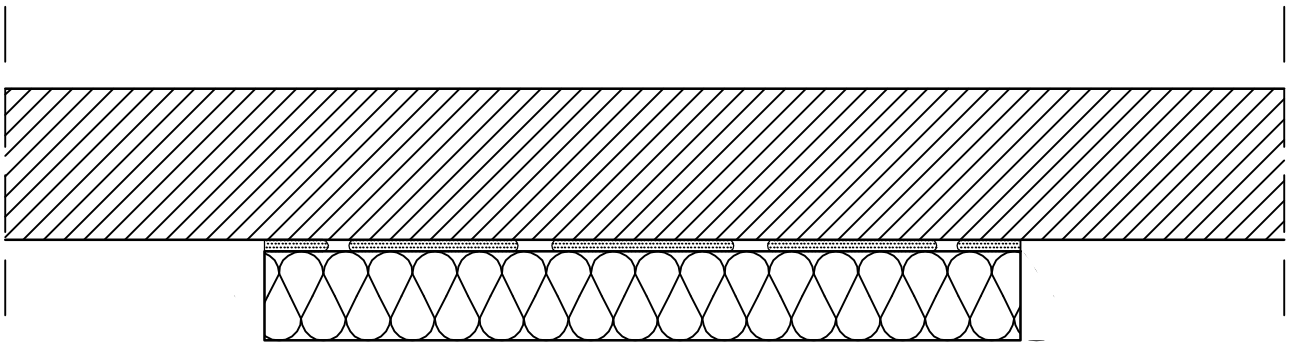
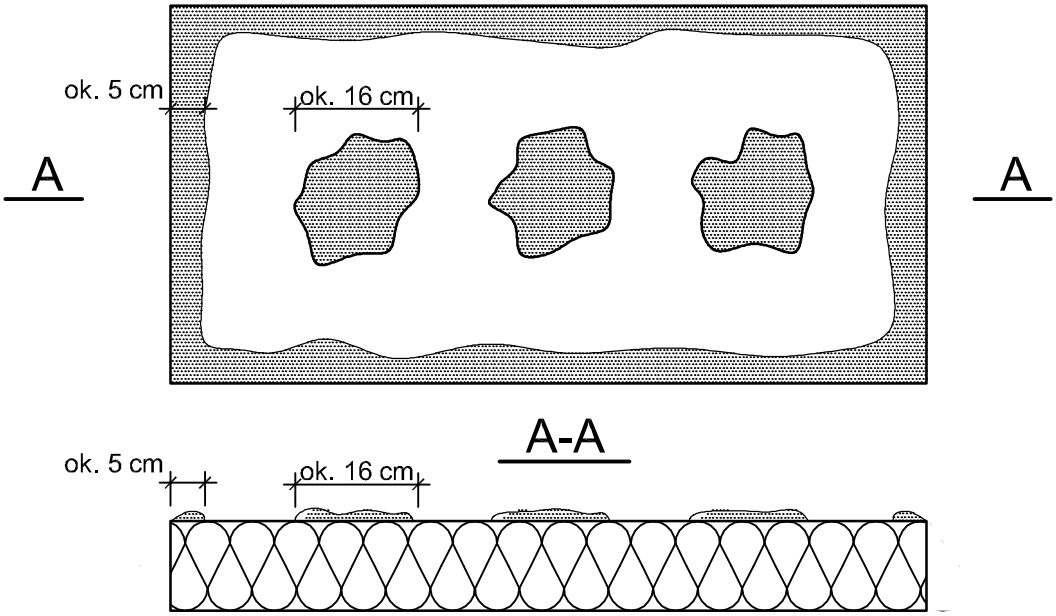
SPOSÓB KLEJENIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ





Uwagi!

Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspresyjnych mas klejowych w przypadku podłoży nienasiąkliwych i drewnopochodnych lub zapraw klejowych do zmieszania z woda na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych. Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje/karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspresyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płyte nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejania płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowane grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środu płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płyte termoizolayjną całopowierzchniowo przy użyciu pasy zembatej (ok. 10mm).

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych producentów jest niedopuszczalne!

EKOPROBUD Firma projektowo-wykonawcza

EkoProBud
Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65
tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl

ADRES INWESTYCJI:	Budynek mieszkalno-usługowy ul. Bielszowicka 114 41-700 Ruda Śląska		
TYTUŁ:	PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO PRZY UL. BIELSZOWICKIEJ 114 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI		
TYTUŁ RYSUNKU:	SPOSÓB KLEJENIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ		BRANŻA: ARCH.
ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. L. Witański nr upr. 743/87	PODPIS:	03-2020
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Ł. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK	PODPIS:	SKALA: 1:10
OPRACOWANIE:	inż. Natalia Profaska	PODPIS:	NR RYS.
KIEROWNIK BIURA:	dr inż. T. Muzyczuk	PODPIS:	8